

插件段員工教育訓練內容

- 一、早上 7：25 集合宣導一天之插件機種所要達到產量，總結前一天之品質達成率，把前一天之不良記錄到個人顏色管理圖中，7：30 準時開線。
- 二、套料上線時，由助理發放到各個工位。班長自己進行上線前對料（依 BOM），開始插件前作業員依個人面前所對應的作業指導書進行對料，如有誤則提出，由班長或助理解決 OK 後進行插件。
- 三、插件時員工必須做姿端正，凳子與斑馬線平齊，靜電環，頭巾必須佩戴好。
- 四、開始插件時電路板由插件一工位放入流水線（如有 SMD 則在放入前進行 SMD 檢查）插件一作業員速度熟練程度比線上其它插件工位要快、好。必須記錄一天所下機種及產量。
- 五、插件所有工位必須要注意以下幾點：
 - ①識別機板所有元件。并知道所要插元件的位置。

②元件不能漏插。插錯，極性元件不能插反。

③立式元件要插到底且垂直於 PCB 板，臥式元件要平貼 PCB 板，要想避免插錯、插反、漏插必須拿零件數目準確，插件手勢正確；作業時精神集中，不可談天說地，插好後必須自行檢查一遍，確保流入下一站為 OK 之半成品。插大件物品時切勿振動 PCB, 以僻免其它小零件跳出。

六、插件目檢站，用鑷子從左向右，由上至下目檢。指向哪里看到哪里。主要檢查項目：

①元件是否有漏插、插錯、插反現象。

②立式元件是否插到底且垂直於 PCB，臥式元件平貼 PCB。變壓器。散熱片。電感等大件要平貼 PCB。

③元件是否有破損等現象。

④除作特殊要求外，所有元件傾斜不大於 5° 最後目檢 OK 之半成品，蓋上所在線印章後過錫流入下段。目檢員必須做好制程檢查記錄與每日生產線各組/站制程不合格率管控圖。

七、作業員作業過程中如中塗有事離開，必須等助理頂位後，

拿離位証方可離開，作業過程中不良品放入紅色待處理盒中，由助理清理，切不可流入下站。
線上環境必須保持整潔，每日靜電環必須檢測。

補焊段員工教育訓練內容

一、剪腳使用前的準備工作及操作方法

- (1) 每天使用氣剪前要點檢氣剪是否鋒利。
- (2) 剪腳過程中 PCB 板與氣剪斜度為 45°C 作業。
- (3) 剪腳時手要平貼於工作台上放入剪腳筐內作業，好處：
 - ①減輕工作中手因懸浮於空中產生耗力。
 - ②放入剪腳筐作業好處為：避免剪下之元件腳濺入芯心內和地板上這樣會造成異音及環境臟亂。
- (4) 剪腳 OK 後 PCB 板傾斜看剪好腳之元件腳是否低於散熱片 Pin 腳。

二、補焊，作業前的準備及操作方法改善對策

- (1) 提前 5 分鐘把烙鐵插好，使正常生產時烙鐵達到所需

要溫度。

- (2) 插好烙鐵後檢查海棉是否保持濕潤。海棉必須保持濕潤，好處：生產過程中錫絲中的染物遺留於烙鐵頭上，這樣就可以在海棉上擦淨染物，避免染物經過烙鐵頭沾於 PCB 板焊點上。
- (3) 補焊過程中如發現錫薄、短路等現象嚴重要立即反映上來，知會波峰機技術員改善焊接效果，好處：
 - ①減少加錫，減少化錫等現象。
 - ②提高工作效率。
- (4) 補焊過程中發現腳未出，缺件等現象，同樣題報給班長或助理。此種現象需要知會插件。好處：
 - ①減少補焊壓件動做。
 - ②減少許多作業不良，如：壓件時造成銅皮翹及焊點動得多造成焊點不良。
 - ③缺件後堆在旁邊，工位看上去亂。
- (5) 補焊散熱片時因 PIN 腳太多，所以壓散熱片時必須同時加熱相關焊點，防止造成 PCB 損傷。手壓散熱片時必須先將電烙鐵移走 3 秒鐘后方可將壓散熱片的手移開。
- (6) 工作站如忙不過來，造成堆機時，應擺放整齊，產品之間不可碰撞。

三、 補焊段不良改善

補焊不良主要來於目檢，當目檢將不良點返回至補焊人員時，補焊人員應作到以下幾點：

- ①了解不良位置及不良現象。
- ②考慮是否可以改善作業方法及操作方法有利於作業。或與班長提出建議。
- ③干部應迅速找出不良原因或尋找出臨時對策：(是否為自身或上站及上段造成不良)。
- ④針對以上問題改善不良，幹部隨時追蹤目檢報表。

四、 目檢作業方法及內容

作業內容：

- (1)要求使用規定的治具進行檢驗。
- (2)按從左到右用竹簽滑動的方法去做檢驗。檢驗內容為：
 - ①元件不可有插錯、插反、歪斜、升高等不良。
 - ②補焊不可有虛焊、漏焊、連焊、包焊等不良。
 - ③有 1PCS 不良就返回於相關工位進行改善。
 - ④不良品及位置記錄於報表中來評定每一位員工的績效獎及產出的品質。
 - ⑤根據不良報表班長每天進行不良追蹤。

五、初測站工作內容

- (1) 準備好生產下機的電性檢驗標準，依作業指導書進行通電測試。
- (2) OK 之半成品在 DC 線輸出尾端掛上流程卡並填入檢驗狀況，日期及檢驗員代號流入下站。
- (3) 如一項不符合初測電性規格需記錄於流程卡上放入不良紅桶送修處理。
- (4) 初測項目一般包括以下幾點：
 - ① 90V 重載電壓及空載電壓.
 - ② 264V 重載電壓及空載電壓.
 - ③ 90V. 264V 短路保護測試.
 - ④ 空載輸入功率的檢測.
 - ⑤ 紋波檢查.
- (5) 隨時保持工作台面及周圍的環境衛生.
- (6) 每天上班之前及下班時檢查治具是否有異常發生. 發現異常時應立即通知班長.
- (7) 初測站有高壓產生. 作業時必須先切斷電源後方可接觸產品

包裝段員工教育訓練內容

一、下機站：

- 1、 首先振動機台，檢查有無錫珠、錫渣存在。
- 2、 檢查機台跳線，銅箔，焊點，有無確實焊好，銅箔有無破損。外觀是否清潔。
- 3、 檢查插座有無刮傷、白膠、黃膠等異物。
- 4、 檢查大電容有無鬆動現象。
- 5、 若需貼小銅箔機種則還需檢查小銅箔有無貼好，以上動作檢查 OK 後，方可上機，流入下站時則要把線材與機芯放在汽泡袋。

二、組裝：

- 1、 檢查 CASE 有無來料不良現象（污點、刮傷、變型等）將不良品挑出，機芯首先裝入下蓋。
- 2、 卡線材時需注意避免線材卡反，卡傷、最後將上蓋裝好後確認無異常時流入下站。

三、LED 檢查：

- 1、 接上電源後 LED 亮時不可有燈歪燈暗燈不亮，燈鏡汽泡等不良現象，OK 後方可裝入塑膠袋中流入下一站。

四、壓超音波：

- 1、 開線前先檢查超音波有無氣壓，若無氣壓則立即反饋。
- 2、 把機對應放入超音波下模中，輕拿輕放，避免碰傷CASE，放平後雙手按熔接鍵（綠色按鈕）OK 後，把塑膠袋拿掉，檢查有無壓傷、縫大、 錯位、等不良現象，OK 後方可流入下一站。

一 機器組件功用

- 1 延遲時間設定：調整開始發振時間。（焊頭在下降到工作物表面停留的時間）；
- 2 熔接時間設定：調整熔接時音波的發射時間；
- 3 硬化時間設定：調整發振之後工作物熔融處冷卻定型時間；
- 4 調整及壓力表：工作壓力之指示及調整設定用；
- 5 音波調整：調整振動子系與發振回路之共振匹配，使轉換效率達到理想；
- 6 振幅表：顯示音波空載或負載工作的振幅強弱；
- 7 選擇開關：自動/手動或音波檢查之選擇；
- 8 音波壓力調整：調整音波發射的功率，通常為 2—4 段；
- 9 過載指示燈：音波發射不正常（超負荷時）之指示；
- 10 下降速度調整：調整焊頭下降速度；
- 11 手輪：升降機體用；

- 12 水平螺母 : 調整焊頭的水平度. 使其能平均壓附在工作物上；
- 13 固定把子 : 固定支柱與機體；
- 14 焊接下降 : 按此鍵開始作業；
- 15 停止上升 : 按此鍵，焊頭緊急上升（與手動上升或意外時用）

二.. 超音波調試

- 1 裝好上模，並盡大力扭緊；
- 2 將選擇開關置與手動，焊頭下降到最低時，針對底模及工作物高度，調整好粗略的熔接位置；
- 3 按停止上升鈕，使焊頭上升，裝入下模將壓力降到 0，讓焊頭自然下降至下模內工作物處，調整好上/下模的對應位置，扭緊下模固定螺絲；
- 4 上升壓力，以手動上升及下降來調整熔接位置高度，然後扭緊固定把手。
- 5 調整壓力（一般為 40—60）
- 6 設定延遲時間（28—38），熔接時間（40—50），硬化時間（60—90）
- 7 按音波檢查鈕，確定音波是否正常，如不正常，調整音波或出力段數；

8 試熔

- (1) 縫隙不均：調整水平螺母
- (2) 縫隙大：如大壓力，或降低熔接位置；
- (3) 熔接不良：加大出力段數；

三. 超音波使用要注意機械安全，高壓安全。

操作：首先檢查超音波有否確定接地，選擇開關置於自動；
將工作物放入熔接機底座，雙手按下操作按鈕，使之依照設定工作。

四 作業規範：

1. 工作物放入熔接底座時應輕放，注意工作物與下模不要碰撞，避免碰傷 CASE。
2. 操作時，雙手置於按鍵處，不可接近焊頭，以防高壓造成傷害
3. 拿出工作物時，用雙手。一手拿插座位置，另一手拿線材位置，不允許隻用一支手拿住線材往外拖，放機時，也要輕放。

五、HI-Pot 測試

- 1、 測試前先點檢儀器是否處於 OK 狀態，測試程序是否

與檢驗規範一致。

- 2、 檢查線材是否有卡反、卡傷、白膠等不良現象，OK 後方可進行測試。
- 3、 線材依據孔徑規格插入相對應的孔徑，將不同的孔徑挑出。
- 4、 測試時不能有漏機現象，測試 OK 後在流程卡上簽上測試員代號與當日日期 NG 品則將不良原因記錄與卡上放入紅色膠盆中待編號維修。
5. 隨時保持工作台面及周圍的環境衛生.
6. 每天上班之前及下班時檢查治具是否有異常發生.發現異常時應立即通知班長.
7. 高壓測試時必需遠離產品. 避免被高壓擊傷. 地面需鋪墊絕緣膠墊.
8. 如出現異常造成堆機時. 產品與產品之間必須用氣泡袋隔離.

六、 ATE 測試：

- 1、 測試前先點檢儀器是否處於 OK 狀態，測試程序是否與當前所投機種一致，OK 後，方可進入測試狀態。
- 2、 線材依據孔徑規格，插入相對應的孔徑，將不符合要求的孔徑挑出。

- 3、 測試過程中若有 NG 品則按 F3 鍵查尋找，將不良現象及數據記錄流程卡上放入紅色膠盆中待維修，OK 品在流程卡上記錄測試員代號方可流入下站。
4. ATE 開機順序為由下至上. 關機順序為由上至下.
5. 每天應保持儀器. 治具衛生. 檢查儀器是否有異常發生.
6. 如出現異常造成堆機時. 產品與產品之間必須用氣泡袋隔離.
7. OK 品之判定為電腦中顯示‘ PASS’ . NG 品則顯示‘ FAIL’ 程序在運行过程中當某一項 NG 時. 該項壞會變成紅色.

七. 目檢：

1. 檢查 CASE 有無刮傷、錯位、臟污、異音等不良現象，將不良品挑出放入紅色膠盆中，不良原因記錄卡上，OK 品方可流入下站。
2. 目檢時必須每個面逐一檢查. 切勿漏失. 特別是 SOCKET 及 CASE 融接處.

八. 模擬測試：

1. 測試前點檢儀器是否處於 OK 狀態，測試時需掌握

此機種之電壓範圍與徑波範圍，DC 插頭插入相對的孔徑，OK 品方可流入下站。

2. 測試前檢查萬用表是否無電及負載是否正常.
3. 每天應保持儀器. 治具衛生. 檢查儀器是否有異常發生.
4. 如出現異常造成堆機時. 產品與產品之間必須用氣泡袋隔離.

九. 貼標籤：

1. 檢查標籤與首件是否一致。
2. 將有刮傷、污點、等來料不良之標籤挑出。
3. 貼好後自主檢查標籤是否有疙瘩、汽泡、歪斜等不良現象，不良品修致 OK 後方可流入下站。
4. 貼 label 時要均勻受力. 不要用力擠壓.

十、貼序號、高壓標籤：

- 1、 在 POWER 標籤貼上序號標籤、序號標籤應貼在 LABRLI” S/N” 處
- 2、 HI-POT OK 標籤則貼在 LABEL 下方之 CASE 上不可貼歪.
- 3、 若有機種需貼客戶料號則貼到要求相應位置上、不可貼歪

- 4、 要按從小到大順序粘貼. 一個序號緊接下一個序號、按照放箱規格分箱、滿箱則要通知下站人員并確認這一箱中的號碼是否正確、序號不可亂掉、不可多貼、或少貼.

十一、摘流程卡

- 1、 將 POWER 標籤上序號對應項寫流程卡上，填卡時應檢查老化、高壓、終測是否有記錄。
- 2、 將流程卡取下，依上站放機須序作業，並依序號流入下站不可亂序號。
- 3、 一個制單做完後應將整個制單內的流程卡依序號依次排好，裝箱保存，以備查核。

十二、DC 線目檢：

- 1、 檢查線材是否有卡反、卡傷、卡歪、線材沾有白膠、黃膠、銅釘臟之不良現象，OK 後方可流入下站。
- 2、 檢查方示為從左到右逐一檢查.

十三、包裝：

- 1、 按照作業指導書要求此機型包裝，檢查外箱、隔板、小白盒汽泡袋規格是否正確，有無破損、污損現象。

- 2、貼外箱時檢查外箱貼紙是否與首件一致，有無打錯現象，外箱封箱前隔板按需求放入。
- 3、序號不能搞混箱。
- 4、滿箱後放入隔板前裝箱人中必須確認是否滿箱，不能有短裝現象，並確認序號是否正確. OK 後方可放入隔板封箱放入站板。

注意事項：

- 1、所有作業人員都必須首先戴好靜電環、手套、頭巾。
不許佩戴手表、戒指等易對 CASE 造成刮傷物品。
- 2、所有作業人員拿機時應輕拿輕放，作業過程中不可污損 POWER 外觀。
- 3、產品在流動中機身與線材全要在汽泡袋上，避免對 POWER 造成損傷。

準備加工段員工教育訓練內容

1. 在加工過程中應注意：
 - A 不同物料不能混裝；
 - B 各元件腳距按 PCB 板實際量取；
 - C 整形時元件插入 PCB 部分不能碰在一起應平行；

D 剪腳過程中不要彎曲元件以利插件；

E 在鎖散熱片時力距要適合，散熱膏要塗抹均勻；

F 加工規格要在作業標準範圍內。

G 作業標準：作業指導書、BOM、檢驗規範

2. 成型二極管：將成型機腳距調試到與 PCB 板位置相符後，腳長調 $3.5+0.3/-0.0\text{mm}$ 之間後成型，在成型前先試插此零件是否調試 OK，在確定 OK 之後再開始成型；
300—500PCS 中抽 10PCS 再次試插是否調試 OK，與 PCB 板是否相符合，成型 OK 後將零件倒入零件袋中，並在零件袋上注明料號、零件位置、規格. 然後分機種分別放入套料中，待套料加工 OK 後再送入插件段。
3. 成型電阻：將成型機腳調到與 PCB 板零件位置相符後再放入幾顆零件試是否調試為 OK。在確認調試 OK 後再成型，在成型過程中成型到 100PCS—300PCS 時抽 5—10PCS 試插是否為 OK，將成型 OK 之材料放入零件袋中，並在零件袋上注明料號、規格、零件位置（如 BOM 表中需加熱縮套管就按 BOM 中套管的規格進行加工，加工 OK 後用熱吹風進行熱縮處理，熱縮之後檢驗熱縮是否 OK，然後將加工好的零件裝入零件袋中放入套料中，待套料加工 OK 後再送入插件段。
4. 整形電容：將電容放置在成型治具中進行成型，將電容腳距整形為與 PCB 一致，剪腳時將腳長保留 $2.5+0.2/-$

- 0.0MM 後，將腳的彎度整為與 SPEC 要求一致，然後將加工好的電容進行排盤，將料號、規格，位置標示清楚放入機種套料中，待套料加工 OK 後再送入插件段。
5. 鎖螺絲：將晶體放入靜電盒中，再拿好相應的治具，散熱片，螺絲，分別擺放標示清楚，再將散熱片放入治具中，將晶體背部抹好散熱膏（如需配用絕緣片+絕緣粒時，應先將絕緣片和絕緣粒分別套入電晶體中）後放到對應的孔位上用電批（扭力為 $4.0 \pm 0.5\text{KG}$ ）將螺絲鎖緊，然後將鎖好的散熱片排在靜電盒中，以便下一道工序作業。
6. 包膠：將加工好的散熱片，用瑪拉膠帶按 SPEC 要求包，膠帶的規格要在 BOM 表的要求範圍內（如 6019 系列中的 H02，用 34MM 的膠帶包兩圈，再包寬為 15MM, 在包兩圈時反折再包一圈）然後將包好瑪拉膠帶的散熱片擺入在靜電隔板上，在擺放 OK 後，將綠膠加點在螺絲與晶體之間，將鎖好的晶體與散熱片加以固定，將點好膠的散熱片待膠幹後放入塑料相中，在外箱用標示單將料號，規格機種名稱標示清楚，待料齊後送入相應的插件段。

錫爐教育訓練內容

一. 操作前準備工作

1. 助焊劑、稀釋劑、清洗劑須遠離錫爐 5 米以外擺放整

齊.

2. 每天早上檢查錫爐溫度是否達到.
3. 助焊劑比重是否過高.
4. 氣壓是否足夠.
5. 錫爐風機是否正常. 爪鏈有沒有變形.
6. 交流接觸器是否正常.
7. 錫波控制調節器是否正常，緊急停止鍵是否正常.

二. 操作注意事項

1. 生產時出現卡板，落板等異常時須及時處理. 防止損毀鍊條或 PCB 板.
2. 錫爐通電後不能打開控制板面. 防止被高壓擊中.
3. 機械出現故障後必須由專業人員維修。

三. 操作細節

操作：打開電源設定錫爐溫度為 $235 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，溫度達到設定值時開氣閥調整氣壓為 $2.0 \pm 0.5\text{Kg}$ ，檢查助焊劑比重是否在 0.83 ± 0.01 如果高出就加稀釋劑降低比重，如果較低加助焊劑保持在 0.83 ± 0.01 調節 PCB 板寬度，控制桿在左下主，此寬度應與生產機型一致，按上預熱開關保持 PCB 板預熱溫度為 $100 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ，按下馬達啟動開關，再按下馬達

開關，調節軌速為.40+-0.15M/Min 再調節入口馬達的靜電皮帶與軌速一致按下爪鏈上的助焊劑，以上 OK 後，按下錫波馬達開關並調整錫波與軌道的角為 3-5°，再按上散熱風扇開關並打開照明燈放板錫爐，對生產不同機型改變錫波（例如：沒有 SMD 的過平流波）過了錫爐後檢查焊點是否光亮，如果有焊點不良（例如：過錫爐後焊點有錫尖，就會檢查預熱溫度有沒有達到設定，如果達到就應該提高預熱溫度，檢查助焊劑比重直到焊點沒有錫尖）

保養：不能扔雜物到錫爐與助槽內，氣壓器內的要及時清除，助焊槽的助焊劑保持清澈洗爪箱內的清洗劑必須保持清潔，錫爐內的錫渣每半小時清理一次，四小時打撈出錫爐，每周對錫爐軸承，爪鏈等活動部位加油及清洗助焊槽。

包銅箔教育訓練內容

一. 下機站：

點膠並注意元件面是否有錫渣，或上站不良之現象，要及時反應於班長，且及時去追蹤，點膠要避免所使用的白膠（黃膠）沾到流水線或機板上，並且看是否有腳長，而反饋與補焊。

二. 焊跳線：

焊跳線需按規定要求去焊，不能私自更改作業，焊接前烙鐵頭要擦乾淨。補焊時用 1.6MM 錫絲，焊點要飽滿光亮，圓滑，焊點不能臟，兩根導線不能和線路板其它短路，也不能距離太近，跳線需一根一根拿不零亂，不使跳線撒落工位上，保持工位清潔。

三. 焊絕緣板：

取上站 OK 品，將絕緣板裝於 PCB 上要與 PCB 板前後左右對齊，不能超出 PCB 板，要目視絕緣板有無刮傷的現象，再把導線分別固定在絕緣板兩頭，用烙鐵焊牢，跳線不能浮於絕緣板上，焊點不能太高，太大，要保證裝機殼時不受阻。

四. 包銅箔：

首先將銅箔折好，銅箔面朝外，瑪拉片朝內，折銅箔時需一個一個的折，並要對好每道折橫，不能折偏，更不能用蠻力將銅箔折損，把折好的銅箔放於膠盤中待焊好絕緣板後進行包裝，包時不能使銅箔遮住 LED 燈，或包偏，包時應檢查銅箔對齊，拉下銅箔上的貼線應集中放在一起再放入垃圾箱中，不可掉落滿地影響環境衛生。

五. 焊銅箔：

將包好的銅箔和絕緣板上兩也的銅箔焊牢固，補焊之銅箔和絕緣板應對齊，接口處不要有空隙，焊接必須牢固，焊點要飽滿，光亮，圓滑不可虛焊，假焊，錫珠，錫渣和錫尖等不良現象，銅箔不能燙翹脫離 PCB 斷裂，瑪拉片不能燙傷，烙鐵頭不能太臟，不可以漏焊，將焊好的 OK 品放在流水線上流入下站。

六. 目檢：

檢查外觀上不能有雜物，臟污的地方，PCB 表面不可以有刮傷或破損，目視輸出線不可有破皮，污損如：黃膠、白膠等，要用靜電刷刷出絕緣板上的污漬，並用竹簽挑動跳線看是否焊接牢固，發現不良及時反應上站，讓上站反工，並告之不良原因，讓其引起注意，降低不良。

七. 貼小銅箔：

貼小銅箔不可歪斜，破損，將需貼小銅箔的機擺放整齊後，加貼小銅箔與 H02 的一端，並且要對一些機種熟悉，要不要加貼小銅箔不確定的應及時問不能善做主張。

八. 其他細節：

以上各工位須帶防靜電手環，包銅箔的戴好手套，不

讓銅箔上沾有指紋影響品質，用電烙鐵的工位每天上班之前要清洗海棉，海棉內含水不能太多或少，太多的水份會導致烙鐵溫度跟不上，焊點不光滑，冷焊現象，也不能太幹，會不能保持烙鐵頭的清潔，所用錫渣必須規定為 1.6；烙鐵為 60W，流水線的機要輕拿輕放，不能使互相碰撞，下機要一台一台按流水線格子放，不可以隨便堆機，機板高度在流水線上不能超高三層以上，每位員工確保下自己所做產品的品質。

老化員工教育訓練

- 1、 將初測 OK 之良品進行老化，選擇老化負載，列如：老化 LAD6019AB4-4G 之機種，它的老化負載是： 3.75Ω ，那麼它的負載數怎麼而來的呢？那就請參考工程所發作業指導書。
- 2、 將機台上至老化車時要輕拿輕放，將電源輸出線插在機台之 A、C 座，再將 DC 線連接頭插在老化車的負載之上，如果以上兩點連接不好，那麼這台機就沒老化，我們老化室的室溫 $40^{\circ}\text{C} \pm 2$ 度，老化車進入老化室，首先將老化車上部電源插頭插好再打開空開關，仔細檢查每個機台是否有輸出或燈閃，或炸機之現象，那怎麼檢查法呢？在每台機之上都有電壓輸出 LED 燈，仍正常發光的則為 OK，如不亮著為 NG，那就要檢查是什麼原因，看是輸出端短路，還是炸機，如是

壞機就拿出老化室，交班長處理。

- 3、 在老化過程中老化人員應 30 分鐘檢查一次燒機情況，如有不良拿出老化室送至班長處理。
- 4、 老化 OK 之良品下機時必須輕拿輕放，擺放整齊，在流程卡老化之段 表示 OK 品。
- 5、老化之目的是為了檢測機台的短期壽命實驗。

老化員工教育訓練

- 1、已修和沒修的機種要分開放置，待修機放於紅桶中，已修好的良品放綠桶裡，將機擺放整齊。
- 2、及時填寫修理報表, 簽寫流程卡注明故障原因. 日期. 修理人代號。
- 3、NG 元件分機種放好、不可亂扔、亂放及時清理退庫。
- 4、修機時不可隨意更換 BOM 表上沒有之元件。
- 5、每天下班前整理好工位, 清理. 保養儀器設備。
- 6、待用元件分開放元件櫃中, 不可混裝。
- 7、下班時, 須關好門、窗、電源等。
- 8、隨時協助製造處理制程中發生的不良及電性異常。